## Xe-PFIBを用いた広域断面のSEM観察

## 数十nmオーダーの狙い精度で数百μm角の断面観察

測定法 :SEM·X線CT·FIB加工

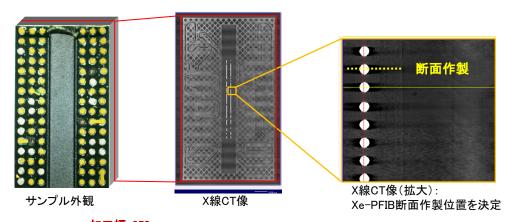
製品分野:LSI・メモリ

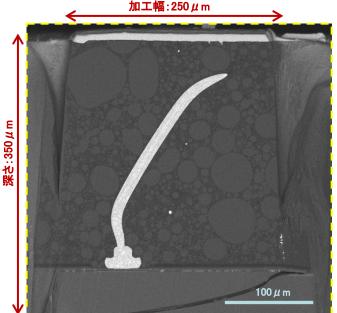
分析目的:形状評価、構造評価、製品調査

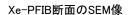
## 概要

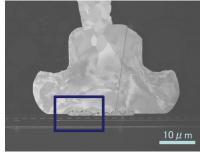
集積回路、電極やプリント基板、半導体パッケージの電極を電気的に接続する金属製ボンディングは直径数十 $\mu$ m~数百 $\mu$ m程です。Xe-PFIB(Xe-Plasma Focused Ion Beam)では数十nmオーダーで加工位置を狙い、数百 $\mu$ m角の断面を作製できるため、ボンディング中央にて全景を詳細に把握することができます。

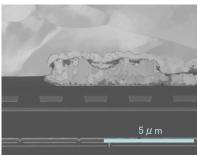
## データ











Xe-PFIB断面のSEM像(拡大)



✓ 数十nmの精度で数百 µm角の断面加工が可能です

〜折サービスで、あたたの研究関発を強力せポート。

**V** ★ 材料科学技術振興財団

URL: https://www.mst.or.jp/